

Ремонтная линия для удаления припоя и исправления дефектов пайки компонентов BGA ZQ3500



Производитель:

Seamark

Цена:

Цена по запросу

Описание

ZQ3500 — это автоматическая линия для ремонта BGA, предназначенная для удаления припоя и исправления дефектов пайки компонентов BGA. Оборудование обеспечивает полную автоматизацию процесса распайки и исправления дефектов пайки компонентов BGA и совместимо с широким диапазоном размеров изделий и диаметров шариков (0,3-0,76 мм). Вся система включает в себя такие функции, как загрузка и выгрузка, визуальное выравнивание, распайка и удаление клея, полировка, очистка, печать флюса, исправление дефектов пайки компонентов BGA, AOI (автоматизированная

оптическая инспекция) и сортировка, охватывая все необходимые процессы для ремонта BGA.

Особенности

Полностью автоматическая ремонтная линия

Вся система представляет собой полностью автоматизированную ремонтную линию, состоящую из нескольких устройств. Управление осуществляется с помощью человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), а каждый процесс контролируется соответствующими датчиками и системами сигнализации для обеспечения стабильной, безопасной и автоматической работы.

Комбинированная система распайки нескольких типов

Система распайки состоит из нижнего подвижного компонента предварительного нагрева в сочетании с модулем бесконтактной пайки с большим и малым соплом, верхнего модуля нагрева горячим воздухом и устойчивого к высокой температуре скребкового модуля. Эти компоненты обеспечивают несколько вариантов процесса распайки. Система может удовлетворить требования по распайке стандартных EGA, BGA с клеем и BGA с компонентами. Система обеспечивает высокую совместимость.

Система полировки и очистки

После распайки система наносит чистящее средство для высокоскоростной полировки, чтобы удалить остатки материала, оставшегося после распайки. Он также оснащен безворсовой бумагой для протирки и очистки, что обеспечивает автоматическую очистку после распайки.

Система печати флюса и высокоскоростной пайки паяльной пастой

Система включает в себя стандартный принтер флюса для обычных BGA. После распайки и очистки флюс наносится непосредственно на поверхность, обеспечивая стабильность и скорость. Для BGA с компонентами на верхней поверхности, которые не могут быть напечатаны напрямую, ремонтная линия оснащена специальным высокоскоростным пьезоэлектрическим клапаном для нанесения флюса в виде точек, что улучшает общую совместимость оборудования.

Система позиционирования и контроля AOI на с помощью CCD

Система оснащена несколькими компонентами CCD для точного перемещения и позиционирования во время загрузки и выгрузки. Ремонтная линия также оснащена системой инспекции AOI, которая инспектирует BGA после исправления дефектов пайки компонентов BGA, эффективно выявляя такие дефекты, как лишние шарики, недостающие шарики, смещение, образование перемычек при пайке и проблемы с размером шариков. Затем система может выполнить сортировку на основе этих результатов инспекции.